

la lettre arcsis

PROVENCE - ALPES- CÔTE D'AZUR

NOV. 2005 - N°16 - PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D'INFORMATION

EDITO

Adieu le Cremsi ! Vive Arcsis !



Avec ce numéro de la Lettre vous découvrirez le nouveau logo et la nouvelle signature graphique de notre association. C'est toute une symbolique du changement. Une page est tournée et nous entrons dans une nouvelle phase.

C'est sur trois grandes catégories de thèmes, différentes par le degré de nouveauté, que vont porter nos efforts dans l'avenir.

1. Il faudra, d'abord, renforcer nos acquis et développer les actions existantes, tant dans l'animation économique de la filière que dans l'organisation d'événements d'échanges techniques et scientifiques, ceci au service de nos adhérents, soit de façon directe, soit à travers le rayonnement et l'image de marque de notre région.

2. Ensuite, après la mise en place des structures et organes de gouvernance, il s'agit de déployer nos trois plateformes du Centre intégré de microélectronique en passant à l'action concrète et opérationnelle. Les efforts passés doivent porter leurs fruits : des projets qui «marchent» et qui donnent des résultats.

3. Et, enfin, nous allons participer pro-activement au formidable potentiel que promet le Pôle de compétitivité à vocation internationale *Solutions Communicantes Sécurisées*. Depuis le début, beaucoup d'entre nous ont vu la nécessité d'ouverture de la microélectronique vers les applications et les logiciels, dans un Pôle de compétitivité ambitieux, couvrant toute la chaîne de valeurs. Ce pôle, nous l'avons voulu et nous avons contribué à le faire labelliser ! Travaillons maintenant ensemble avec tous les partenaires, dans un esprit gagnant-gagnant, pour que le Pôle SCS aboutisse et que, en même temps, les associations qui le portent se développent.

C'est à la fois un plaisir et un challenge de prendre la présidence d'Arcsis en cette période de mutation, car si notre association est dynamique, l'environnement ne l'est pas moins. Je vous invite tous, membres d'Arcsis, amis et partenaires publics, à nous rejoindre pour construire l'avenir ensemble !

Erich Palm
Président d'Arcsis

L'ÉVÉNEMENT

OCOVA 2005

Les nouvelles perspectives des solutions multiapplicatives dans les transports et la vie quotidienne.

GAP, 29 SEPTEMBRE 2005 - Le forum OCOVA 2005 qui s'est tenu le 22 septembre dernier au domaine de Charance à Gap a fourni une parfaite illustration du dynamisme des acteurs régionaux de la filière du pôle de compétitivité *Solutions Communicantes Sécurisées*.



150 cadres et dirigeants d'entreprises, responsables de laboratoires de recherche, d'organismes de développement ainsi que des représentants des collectivités territoriales ont participé à cette deuxième édition consacrée aux solutions communicantes sécurisées innovantes. Aux côtés de représentants du pôle voisin Minalogic Grenoble-Isère et des autres pôles oeuvrant dans les domaines des sciences et technologies de l'information et de la communication, le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées PACA a présenté son plan d'action : un effort coordonné sans précédent de recherche, d'innovation et de développement avec en perspective 400 millions d'euros d'investissements d'ici à 2009 et la création de 25 000 emplois directs nouveaux en 10 ans. Présent pendant les débats, le ministre délégué à l'aménagement du territoire Christian Estrosi a réaffirmé l'appui de l'État à l'action des industries, des PME et des laboratoires de recherche associés dans les pôles de compétitivité.

Une large part de la matinée, placée sous la présidence de Christiane Schwartz, Direc-

trice de l'Innovation à France Telecom, était consacrée aux usages émergents des solutions multiapplicatives dans la vie quotidienne. Les présentations d'Amadeus et d'IBM sur les applications dans les domaines du transport, du voyage et de la santé ainsi que celle d'Octopus à Hong Kong — via visioconférence — sur sa carte multiapplicative sans contact qui génère 8 millions de transaction par jour dans les transports et les services, ont fourni une riche matière aux débats animés par Aglaé Emelien, spécialiste de monétique. La table ronde réunissait acteurs de la monétique, opérateurs des télécoms et professionnels du tourisme (Bouygues Telecom, BMS-Monéo, MasterCard, et Rémy-Loisirs) pour des échanges stimulants avec les participants sur les obstacles au développement des cartes multiapplicatives sur les marchés français et européens, les actions en cours et les évolutions attendues.

Placé sous la présidence d'Alain Le Roy (CEA-Leti), Atmel, France Télécom R&D, Gemplus, Inside Contactless, Philips, STMicroelectronics ont présenté les évolutions en matière d'interopérabilité carte à puce/téléphone portable/réseaux ainsi que les perspectives de la RFID. La dernière partie de la journée rassemblait les organismes d'appui au développement (Méditerranée Technologies, OSEO-Anvar, Drire) des capitaux risqués (Innovacom) ainsi que des entrepreneurs dans des échanges particulièrement animés et fructueux sur l'accès au financement des entreprises et l'appui à leur développement orchestrés par Jean-Pierre Gloton, co-fondateur de Gemplus et business angel.

Les organisateurs Arcsis, Hautes-Alpes Développement, Méditerranée Technologies, Micropolis et le pôle SCS prennent date pour le forum 2006.

→ www.ocado.com

perspectives de la RFID. La dernière partie de la journée rassemblait les organismes d'appui au développement (Méditerranée Technologies, OSEO-Anvar, Drire) des capitaux risqués (Innovacom) ainsi que des entrepreneurs dans des échanges particulièrement animés et fructueux sur l'accès au financement des entreprises et l'appui à leur développement orchestrés par Jean-Pierre Gloton, co-fondateur de Gemplus et business angel.

Vendre en Asie

Délégation d'industriels asiatiques sur le thème de la RFID pour la logistique

Cet évènement co-organisé par Arcsis et Ubifrance se déroulera les 28 et 29 novembre à Rousset et Sophia. Au total, 10 entreprises régionales, principalement membres d'Arcsis, participeront à l'évènement et rencontreront les acheteurs asiatiques en vue d'établir des relations commerciales privilégiées.

L'innovation globale et durable

Cap Innovation Méditerranée

La 2^e édition, organisée par la CCI Marseille-Provence, la CCI Nice Côte d'Azur et Euromed Marseille École de Management, va **récompenser l'innovation globale et durable** (technologique, commerciale, culturelle, sociale, caritative et environnementale) avec un intérêt particulier pour les projets euroméditerranéens. Cap Innovation Méditerranée intègre deux trophées : le Trophée de l'entreprise innovante et citoyenne et le Trophée de l'entreprise étudiante innovante euroméditerranéenne.

Barcelone

3GSM WORLD Congress

La prochaine édition du 3GSM aura lieu à Barcelone du 13 au 16 février 2006. Telecom Valley 2006 vous accueillera sur un stand de 72 m².

→ www.futuring.fr/3GSMo6/tvo6.html

Capital-risque

9th International Venture Capital Summit

IVCS 2005 se déroulera les 1 & 2 décembre à Sophia Antipolis. Co-organisé par Mar-Tech & Finance et la CCI Nice Côte d'Azur, cet évènement a pour objectif de favoriser les alliances et les rapprochements entre entreprises innovantes et grands groupes avec l'appui de capitaux-risqueurs. Parmi les grands acteurs qui ont déjà annoncé leur participation : Alcatel, Cadence, IBM, Infineon, Nokia, STMicroelectronics, Texas Instruments...

Des actions pour développer le business des PME

Trois projets majeurs sont en chantier pour favoriser l'accès des PME aux marchés B2B de la filière.

L'action de business développement, engagée par Arcsis depuis six mois auprès des PME de la filière « Microélectronique & objets communicants », se traduit déjà par plusieurs retombées positives, en particulier l'adhésion d'une dizaine de nouveaux adhérents. La démarche s'organise autour de trois grands projets structurants :

- La mise en place d'une démarche de veille technologique et stratégique ;
- le développement d'une plate-forme B2B (business to business) ;
- l'accompagnement des PME dans des démarches ciblées de prospection et de développement technologique au niveau local et international.

Dans le domaine de **la veille**, un projet pilote a été initié avec le soutien du Sgar et de la Drire auprès d'une dizaine de participants : PME, laboratoires et grands groupes. Cette action vient en soutien des développements technologiques instruits dans le cadre des plates-formes collaboratives et devrait connaître un déploiement dans le cadre du pôle mondial SCS.

En complément, un projet logiciel est lancé pour déployer **une plate-forme collaborative B2B**. Cet outil de promotion et d'animation s'adresse aux différentes communautés d'Arcsis. La plate-forme fournira un espace convivial et sécurisé pour l'échange d'informations et de données. L'interface

web permettra de promouvoir les activités d'Arcsis mais aussi de favoriser le développement commercial des PME adhérentes. La plate-forme B2B donnera une visibilité globale de l'offre de produits et services des industriels régionaux, favorisant ainsi un flux de visiteurs et l'émergence de besoins.

En complément de cet outil, plusieurs **actions de business développement** ont été engagées. Au sein de la filière, des cocktails B2B sont organisés tous les deux mois avec plus d'une trentaine d'adhérents pour favoriser l'émergence de projets. Sur les aspects technologiques, plusieurs actions collectives sont en cours. Avec le Critt chimie, une action collective de sensibilisation et de formation est engagée sur les impacts de la directive européenne Reach sur la microélectronique.

Au niveau international, Arcsis collabore étroitement avec Ubifrance pour recevoir une délégation d'acheteurs japonais sur le thème des nanotechnologies et d'acheteurs asiatiques de Hong-Kong et Singapour. Parallèlement, Arcsis et Méditerranée Technologies sont heureux d'accueillir le French Tech Tour à Rousset le 17 novembre, il rassemble une soixantaine de capitaux-risqueurs et investisseurs internationaux.

Vincent Boisard

Alliances & Business Development Manager
vboisard@cremsi.org - 04 94 03 89 20

PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

Ca y est ! Les trois Plate-formes ont déposé leurs statuts et sont passées au Journal Officiel.

Caractérisation

PRÉSIDENT : AHMED CHARAI, DOYEN DE L'UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE AIX MARSEILLE

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL : PASCAL GALAND, DÉTACHÉ PAR STM - RESPONSABLE DU LABORATOIRE CENTRAL DE STM ROUSSET

La plate-forme Caractérisation recevra ses premiers équipements (D-SIMS et micro-AUGER) dans le courant du 1^{er} semestre 2006. Ils seront installés temporairement sur le site de ST Rousset en attendant la construction du futur laboratoire sur la zone. Les équipements seront accessibles à tous les partenaires de la plate-forme.

Micro-packs

PRÉSIDENT : PHILIPPE COLLOT, DIRECTEUR DU CENTRE MICROÉLECTRONIQUE DE PROVENCE GEORGES CHARPACK

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL : MICHEL THOMAS, DÉTACHÉ PAR GEMPLUS - BUSINESS DEVELOPMENT GROUP/ARCS

La plateforme Micro-PackS déménage ! Récemment hébergée sur le site de la Maison Pesquier à Gardanne par le Centre de microélectronique de Provence Georges Charpack, Micro-Packs est désormais localisée sur le site du Puits Yvon Morand où le CMPGC installe par ailleurs son équipe PS2 - 10 personnes (électronique sur support souple).

Bonne nouvelle, son plan d'investissement 2005 a été voté par le conseil régional et le conseil général des Bouches du Rhône soit respectivement 0.3M€ et 1.5 M€.

Conception

PRÉSIDENT : CHRISTIAN PICHOT, DIRECTEUR DE RECHERCHE DU LABORATOIRE LEAT

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL : BRUNO DELEPINE, DÉTACHÉ PAR PHILIPS - DIRECTEUR DES RELATIONS EXTÉRIEURES FRANCE SUD-EST.

La plateforme a sélectionné dès la mi-septembre les meilleures offres d'équipement de logiciel de synthèse et de CAO électronique, d'appareils de mesures et de serveurs de calculs, suite à l'appel d'offres lancé par le CNRS grâce au soutien du Conseil général des Alpes maritimes de 1.3 M€.

FLASH

SAME 2005, le forum microélectronique de Sophia-Antipolis (5, 6 octobre) Succès national confirmé, plus d'info sur :

→ www.same-conference.org

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Erich Palm, président d'Arcsis

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Céline Auger

COORDINATRICE DE RÉDACTION

Corinne Joachim

CONSEIL

Christian Apothéoz

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Yann Bidault, Vincent Boisard, Angéline Fraud, Philippe Monteillier, Jean-Claude Nataf, Erich Palm, Rodolphe Uhlmann, Thierry Valet.

PUBLICATION SOUTENUE PAR

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Général du Var, la Mairie de Rousset, le Ministère de la Recherche et les adhérents d'ARCSIS.



BP 19, place Paul Borde,
13790 ROUSSET
tél. : 04 42 53 81 50
fax : 04 42 53 81 51

L'étiquette intelligente de Tagsys a conquis les hôpitaux publics marseillais.

Succès pour Tagsys, l'entreprise américaine dont la filiale Europe est basée à la Penne sur Huveaune. Les labos de biologie s'ouvrent à ses étiquettes Rfid....

Tagsys, société française et leader mondial des systèmes et étiquettes RFID (Identification par radio fréquence) pour la traçabilité d'objets, a installé, en partenariat avec la société Cybernétix, ses systèmes d'identification et traçabilité dans quatre des plus prestigieux laboratoires publics français de recherche biologique : l'Institut Paoli Calmettes (Centre régional de lutte contre le cancer), l'Hôpital de la Timone, l'Hôpital de la Conception et l'Hôpital Nord. L'étiquette ARIOTM SDM de Tagsys permet un suivi et une gestion fiables, précis et sécurisés des échantillons biologiques en bio banques.

Cette étiquette a été spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie pharmaceutique et bio-médicale en terme de sécurité, précision et rapidité de suivi de prélèvements biologiques en laboratoire, par exemple, les échantillons de tumeurs. Il est ainsi possible de contrôler un grand nombre d'échantillons biologiques de manière plus fréquente et régulière, tout en augmentant la quantité d'informations disponibles et en améliorant la qualité et la rapidité des traitements.

D'un diamètre de 8,9 mm, l'étiquette Ario SDM est la plus petite étiquette RFID du marché. Sa taille permet notamment son intégration dans les capuchons de tubes cryogéniques. Robustes et fiables, ces étiquettes fonctionnent parfaitement lorsqu'elles sont soumises à de fortes variations de températures (azote liquide par exemple).

Tagsys figure parmi les rares sociétés qui offrent des solutions complètes pour le suivi d'articles (comportant des puces, étiquettes, antennes, lecteurs, logiciels, intégration, etc.) avec quasiment 100 % de succès de lecture ; un résultat essentiel dans une industrie où la précision et le taux d'erreur ont une influence directe sur le bien-être du patient. Le logiciel a été développé par Cybernétix, partenaire de Tagsys sur ce projet.

« Les besoins de l'industrie médicale en matière de suivi et de sécurité d'échantillons biologiques par la technologie RFID sont connus, » affirme Élie Simon, président du directoire. « Tagsys se focalise sur le développement de solutions complètes qui répondent aux besoins précis de marchés bien identifiés. Nos succès dans les laboratoires de recherche médicale sont la preuve que cette technologie apporte des avantages indéniables lorsqu'elle est adaptée à son environnement. »

Angéline Fraud
Responsable communication



L'Ario SDM est la plus petite étiquette RFID du marché

ÉLIE SIMON
« Tagsys se focalise sur le développement de solutions complètes qui répondent aux besoins précis de marchés bien identifiés. »

In silicio : décollage assuré

Née en septembre 2004, In Silicio travaille déjà pour des leaders mondiaux et élargit son offre de services et produits.

In Silicio est une société qui développe et commercialise des technologies, services et produits logiciels pour la conception assistée de procédés, équipements et composants micro et nanoélectroniques (« Technology computer assisted design », ou T-CAD). On trouve au cœur des solutions d'In Silicio une technologie innovante et propriétaire de modélisation de phénomènes de transport particulaire (molécules, atomes, électrons...).

In Silicio, implantée au Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) sur l'Europôle de l'Arbois, à Aix-en-Provence, a démarré son activité au mois de septembre 2004. Soutenue en particulier par Impulse, Oséo/Anvar, la région PACA, Provence Promotion, la Sofirem, et la SMC, In Silicio a été lauréat du concours d'aide à la création d'entreprise innovante du ministère délégué à la Recherche en 2004.

Dans les douze premiers mois de l'activité qui viennent de s'écouler, plusieurs jalons importants ont pu être franchis : consolidation du plan de financement, constitution du noyau de l'équipe de recherche et développement, lancement de collaborations avec plusieurs équipes académiques de premier plan en France, en Europe et au Japon, développement et validation d'une première génération de plateforme logicielle de simulation. Ceci a permis d'établir dès mars 2005 une offre de services, et les signatures de plusieurs contrats clients sont intervenues ces derniers mois.



Ce démarrage précoce de la commercialisation d'une offre de services de modélisations et d'aides à la conception, basée sur la plateforme technologique de première génération désormais validée, permet aujourd'hui à In Silicio d'établir sa présence sur ses marchés de lancement, et de sécuriser ses axes de développement. Les premiers clients, souvent des leaders mondiaux dans leur secteur, sont des fabricants de composants et systèmes, ainsi que des équipementiers ; dans les industries du disque dur magnétique, de la microélectronique, et des traitements de surface. Ce sont pour l'essentiel des entreprises basées en Amérique du Nord, dans la zone Asie-Pacifique, et dans une moindre mesure en Europe. Un logiciel commercial de modélisation, basé sur la plateforme de première génération, sera lancé en 2006 ; ce qui viendra compléter l'offre de services par une première offre de produit.

Thierry Valet
Président et cofondateur

La start-up Kemesys séduit les capitaux-risqueurs

Kemesys Créée par Bernard Laborie et Georges Michaël, la société travaille sur les consommables et les services utilisés lors de la fabrication des circuits intégrés. Kemesys élabore des suspensions de polissage et des services associés pour le polissage mécano-chimique. L'objectif de la levée de fonds étant de « financer la poursuite des qualifications souvent très longues auprès des grands des semi-conducteurs et le besoin en fonds de roulement lié au démarrage de l'activité », expliquent les nouveaux actionnaires dans la lettre Sud Infos.

CIC Vizille Capital Innovation (Lyon) et sa filiale Sudinova SA ont investi 900 K € tandis que deux autres capital-risqueurs sont sur le point d'injecter 400K €.

→ www.kemesys.com

IBS partenaire du programme européen NanoCMOS

La Commission Européenne a lancé en mars 2004 un projet de partenariat entre entreprises et centres de recherche, baptisé NanoCMOS, destiné à conforter la place de l'Europe à la pointe de la technologie des semi-conducteurs. Il s'agit de démontrer la faisabilité de la technologie logique CMOS 45 nm (semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire). Un an et demi après le début du projet, en avance sur leur calendrier, les partenaires ont réalisé, en tant que dispositif de démonstration, deux puces SRAM, affichant les meilleures caractéristiques au monde, qui pourront avoir des applications dans l'industrie manufacturière et celle des technologies de la société de l'information. Parmi les entreprises partenaires, IBS, situé à Peynier (13), est spécialisée dans le traitement de surface par faisceau d'ions.

→ www.nanocmos-eu.com

Jean Claude Nataf, STMicroelectronics et Philippe Monteillier, Gemplus.

SCS, pôle d'avenir de la région

Depuis le début 2005 Jean Claude Nataf et Philippe Monteillier ont participé avec beaucoup d'autres intervenants de la région au montage du dossier du pôle SCS. Entretien.

Arcsis : Pouvez-vous nous faire un bref récapitulatif des événements de ces derniers mois ?



Jean-Claude Nataf : Le dossier pôle SCS, « Solutions communicantes sécurisées » qui a été déposé le 28 février dernier en préfecture de région a reçu le label « pôle mondial » lors du CIADT du 12 juillet 2005 avec cinq autres pôles de compétitivité.

C'est un résultat exceptionnel mais pas vraiment inattendu, le pôle SCS concentre en son sein tous les ingrédients pour pouvoir rivaliser avec les plus grands pôles TIC mondiaux : masse critique, ouverture internationale, marchés des SCS mondialisés, aura internationale de la région PACA, etc. Notre ambition est de faire de ce pôle le fer de lance de l'expansion économique de la région. De plus, nous avons déjà des contacts avec d'autres pôles en Chine, au Japon, avec le pôle de Kista en Suède. Des entreprises françaises hors du périmètre géographique du pôle, mais aussi d'autres pôles de compétitivité nationaux souhaitent collaborer avec nous.

Arcsis : Cette question des projets est au centre du pôle, comment s'y joindre ?

Philippe Monteillier : L'intérêt d'être membre du pôle pour une PME ou une grande entreprise membre d'une association d'industriels régionaux est de toute évidence la possibilité de bénéficier de la synergie de projets transversaux sur la chaîne de valeur. Les entreprises trouveront au sein du Pôle les moyens mutualisés, les plates-formes, les aides au montage de projet (d'envergure euro-

péenne ou mondiale) et les interlocuteurs et partenaires pour monter les projets qui leur tiennent à cœur sur la chaîne de valeur.

Arcsis : Quelles sont les associations qui participent au pôle SCS ?

PM : Arcsis bien sûr, qui est avec Telecom Valley l'un des deux piliers du pôle. Mais aussi Baby Smart, MedMultiMed, MedInSoft, le Club Hi-Tech, la Fondation Sophia-Antipolis ou d'autres à venir.

Arcsis : Quels sont les chantiers à venir dans lesquels le pôle est impliqué ?

PM : Avant de parler d'événements, je voudrais dire que notre tâche ne s'arrête pas à la finalisation du contrat cadre avec l'état. Ce n'est que le début ! Il nous faut maintenant, au-delà de la constitution de l'association et l'approbation de son budget, nous doter d'outils pour l'infrastructure du pôle. Des outils d'intelligence économique, mais aussi des plates-formes collaboratives, qui nous permettront de partager efficacement l'information et des outils de communication dignes d'une structure comme celle du pôle. Enfin, il nous faut démarrer le processus de sélection des projets 2006 sans tarder. Nous devons travailler sur le développement international du pôle et il nous faut chiffrer, plus précisément, les objectifs que nous voulons atteindre.

Nous serons présents et actifs sur les grands événements de la profession. Nous allons entendre également des rencontres avec d'autres Pôles pour comprendre les complémentarités possibles.

Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le travail qui manque et les occasions de travailler ensemble à notre projet et de le faire connaître sont d'ores et déjà nombreuses...

Technologies lasers

Workshop "Applications laser en microélectronique et optoélectronique"

Co-organisé par Arcsis, le centre Claire, POPSud et le LP3, le 1^{er} décembre à Fuveau (ST University) de 14 heures à 18 heures ce workshop donne un aperçu global des dernières technologies lasers employées dans le domaine des semi-conducteurs. Les présentations porteront en particulier sur les applications de marquage, d'ablation, de nettoyage et d'enrichissement. Cette journée s'adresse tout spécialement aux ingénieurs, techniciens travaillant sur les procédés de fabrication de composants microélectroniques et de mise en œuvre de systèmes électroniques

Contrôles

AEC/APC

La conférence européenne "Advanced Equipment Control/Advanced Process Control" se tiendra du 29 au 31 mars 2006 à Aix en Provence. Arcsis est co-organisateur. Appel à communications sur le site web → www.aecapc-europe.com

L'implantation ionique

IIT 2006 : "Ion Implantation Technology"

La 16^e conférence internationale sur l'implantation ionique se déroulera du 11 au 16 juin 2006 à Marseille. Co-organisée par Arcsis, IBS, les Universités de Surrey et de Provence en partenariat avec Atmel, STMicroelectronics, les Universités de la Méditerranée et Paul Cézanne, la conférence rassemble des ingénieurs, scientifiques et académiques mondiaux de l'implantation ionique spécialisés dans les semi-conducteurs et les équipements de contrôle et de fabrication. Elle est le rendez-vous mondial de l'implantation ionique et de ses avancées technologiques, allant de la compréhension des phénomènes d'interactions ions - état solide aux derniers développements des applications industrielles. Pour plus d'informations : → www.iit2006.com

Merci Laurent Roux !

Le Cremsi a été lancé en 1993, au début sans grands moyens mais avec le soutien très actif des collectivités territoriales. Le cœur de l'association était alors le Comité Scientifique et les projets coopératifs entre acteurs régionaux de la microélectronique.

En septembre 1996, Laurent Roux, PDG d'IBS, est élu à la présidence. Le Cremsi s'oriente davantage vers les PMI, suivant en cela la volonté des collectivités territoriales. Les projets de recherche se diversifient. Le recrutement, en 1998, de la première déléguée générale permet d'élargir le champ d'action. C'est l'année aussi des 1^{ers} Rencontres techniques et scientifiques qui verront leur huitième édition cette année. La Lettre du

Cremsi, lancée en 2002 et la création du site Internet, ainsi que la participation à des pavillons et stands lors de salons internationaux, contribuent à la valorisation et la notoriété de la filière.

Si le Cremsi fête ses 10 ans en 2003, ce n'est pas pour se reposer sur ses lauriers. Plus récemment, en se regroupant avec le Same et avec de nouvelles adhésions, notamment de TI, Philips et de l'Inria, le Cremsi prend vraiment sa dimension régionale. La création du Centre intégré de microélectronique Provence Alpes Côte d'Azur fut sans doute un préalable indispensable à la labellisation récente du Pôle SCS dans la catégorie des pôles de niveau mondial.

Un grand merci à Laurent Roux, non seulement d'avoir présidé aux destinées du Cremsi pendant les huit dernières années si riches en événements, mais aussi d'être toujours disponible et prêt à œuvrer pour le Cremsi, devenu Arcsis.

Propos tenus par Erich Palm au conseil d'administration du 30/09/2005

